

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2026-028

中微半导体（深圳）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,300 万股，发行价为每股人民币 30.86 元，共计募集资金 194,418.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币 98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 5,892,033.96 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 184,008.74 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,947.86 万元后，公司本次募集资金净额为 181,650.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 8 月 2 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	194,418.00
其中：超募资金金额	108,765.23
减：直接支付发行费用	12,767.91
二、募集资金净额	181,650.09
减：	
以前年度已使用金额	54,559.39
本年度使用金额	1,201.28
暂时补流金额	
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-股票回购	3,045.00
其他-永久性补流	110,288.23
其他-项目结项节余资金永久性补流	12,356.75
加：	
募集资金利息收入	8,818.30
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金应有余额	4,017.74
四、报告期期末募集资金实际余额	4,082.68
五、差异	-64.94

注：差异 64.94 万元构成为实际结余募集资金中 64.94 万元，系以公司自筹资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中微半导体（深

圳)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中微半导体(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月20日分别与中国农业银行股份有限公司深圳南山支行和招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》;连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年9月23日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳华联支行、中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司和四川中微芯成科技有限公司(系中微半导的全资子公司,以下简称“四川中微芯成”)连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年10月10日、2022年11月23日分别与交通银行股份有限公司深圳学府支行和中信银行股份有限公司深圳前海支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司和四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年8月10日分别与中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金四方监管协议》;公司、四川中微芯成连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年7月5日分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方或四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》及《关于公司首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意对公司 IPO 募投项目结项，并将部分节余募集资金 10,000 万元用于公司“IPM 产线项目”。根据前述变更情况，公司开立了新的募集资金专户，用于公司 IPM 产线项目募集资金的存储、使用与管理，公司和中微资芯科技（四川）有限公司（系中微半导体全资子公司，以下简称“中微资芯”）连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2026 年 04 月 01 日与中国工商银行股份有限公司资阳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2022 年 8 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户 状态
中微半导体（深圳）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳南山支行	41014100040050868		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755903282610616		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000209688380		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳华联支行	4000021629221883806		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行	757576189722		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司桃园支行	682998899		已注销 （注 1）
中微半导体（深圳）股份有限公司	兴业银行深圳高新区支行	337130100100477025		已注销 （注 1）

四川中微芯成科技有限公司	中信银行股份有限公司深圳前海支行	8110301012800642317		已注销 (注1)
四川中微芯成科技有限公司	交通银行股份有限公司深圳学府支行	443066450013006292252		已注销 (注1)
四川中微芯成科技有限公司	中国民生银行股份有限公司桃园支行	688886696		已注销 (注1)
四川中微芯成科技有限公司	浦发银行深圳西乡支行	79460078801900001002		已注销 (注1)
四川中微芯成科技有限公司	中国民生银行股份有限公司桃园支行	656558899		已注销 (注1)
中微资芯科技(四川)有限公司	中国工商银行四川资阳分行	2312034919100118260	4082.68	使用中

注1：截止2026年6月30日，专用账户对应募投项目已结项并进行销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月23日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币6,293.68万元，使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币177.45万元，合计置换资金总额为人民币6,471.13万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年8月2日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
1	19,356.49	1,772.55	1,772.55	2023/03/15	2022/12/23
2	13,253.32	962.28	962.28	2023/01/05	2022/12/23
3	28,275.05	3,558.85	3,558.85	2023/01/05	2022/12/23

合计	60,884.86	6,293.68	6,293.68		
----	-----------	----------	----------	--	--

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司 2025 年 8 月 5 日发布了《中微半导体（深圳）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4.0 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品余额为 5,000 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 2 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 4.0 亿元	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品	2025 年 8 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	2025 年 8 月 1 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 8 月 2 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中微资芯科技（四川）有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000	2026/6/12	2026/9/14	/	5,000	1.6%	/

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》及《关于公司首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金 12,083.43 万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金 10,000.00 万元用于新募投项目——“IPM 产线项目”。为保障新募投项目顺利实施，公司拟在四川省资阳市设立全资子公司中微资芯科技（四川）有限公司（以下简称“中微资芯”），并向中微资芯实缴注册资本 10,000 万元以实施“IPM 产线项目”。该事项已经董事会、股东会审议通过，保荐机构亦发表了明确的同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022 年 8 月 2 日				
节余募集资金合计金额			22,083.43				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目	4,690.27	用于补流	/	/	/	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 27 日
物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目	2,633.13	用于补流	/	/	/	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 27 日
车规级芯片研发项目	4,760.03	用于补流	/	/	/	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 27 日
车规级芯片研发项目	10,000.00	用于募投项目	IPM 产线项目	10,000.00	10,000.00	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 27 日

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过 30.86 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 7 月 24 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,506,639 股，占公司总股本的比例为 0.38%，回购成交的最高价为 24.77 元/股，最低价为 16.35 元/股，回购均价为 20.21 元/股，使用资金总额为 30,447,268.11 元（不含

交易佣金等交易费用），剩余资金留存在证券回购股份专用账户中。

公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2025 年 10 月 31 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，会议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 14,240.06 万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金”，故上述剩余资金留存在证券回购股份专用账户中本期已不属于募集资金范围。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第六次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》和《关于首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金 12,083.43 万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金 10,000 万元用于新募投资项目——“IPM 产线项目”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 8 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			1,201.28										
已累计投入募集资金总额			169,093.90										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

										体到 月 份)			
大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目	研发	否	19,356.49	19,356.49	19,356.49	0	15,955.51	-3,400.98	82.43%	2026年3月	1,860.17	是	否
物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目	研发	否	13,253.32	13,253.32	13,253.32	0	11,377.93	-1,875.39	85.85%	2026年3月	2,334.50	是	否
车规级芯片研发项目	研发	否	28,275.05	28,275.05	28,275.05	283.09[注 1]	15,509.04	-12,766.01	54.85%	2026年3月	2,084.30	是	否
补充流动资金	补流	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0.00	100.00%	/	不适用	不适用	否
IPM 产线项目 [注 2]	生产建设	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	918.19	918.19	-9,081.81	9.18%	2028年12月	不适用	不适用	否
项目小计	/	/	/	/	/	1,201.28	55,760.67	/	/	/	/	/	/
超募资金投向													
超募资金						0.00	113,33						

[illegible]

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2022年9月9日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，于2022年9月28日召开了2022年第二次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币32,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司于2023年9月26日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于2023年10月13日召开了2023年第一次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币32,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司于2024年9月26日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年10月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币32,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司于2025年10月14日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年10月31日召开了2025年第三次临时股东会，会议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币14,240.06万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况”相关内容。
募集资金其他使用情况	公司2024年大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目、物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目、车规级芯片研发项目，“研发费用”投入中，包括委托其他全资子公司进行研发的相关支出。2024年8月28日公司发布了《关于调整募投项目内部投资结构的公告》，经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”、“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”、“车规级芯片研发项目”的内部投资结构。

	公司于 2026 年 2 月 11 日召开董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第六次会议，于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》和 《关于首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意公司对公司 IPO 募投项目结项，并将节余募集资金 12,083.43 万元用于永久补充流动资金，将节余募集资金 10,000 万元用于新募投项目——“IPM 产线项目”。
--	---

[注 1] 为项目结项后尚未支付的项目尾款及质保金等

[注 2] 为项目结项后使用节余募集资金建设的新募投项目——“IPM 产线项目”